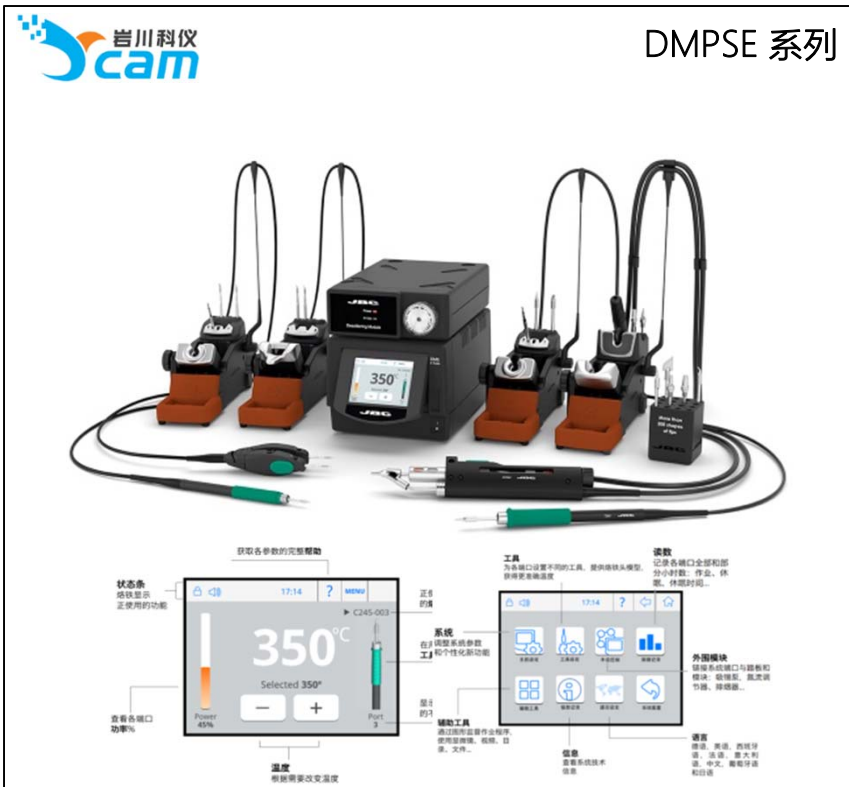




THT+SMD返修工作站

■ 产品用途

焊接和返修拆焊THT插件、连接器、航空插头、线缆、PCBA等类型的产品

焊接和返修拆焊SMD贴片器件、SOP、三极管、QFP、PCBA等类型的产品

■ 产品特点

- 配置通用焊笔、精密焊笔、除锡枪、镊夹，满足焊接和除锡拆卸返修应用
- 电动或气动 除锡泵，满足不同场景和高负压吸力
- 除锡枪发热咀/真空咀二合一，加热快速，真空持续稳定，可在极小空间作业
- 镊夹可同时加热多个位置，加热快速稳定，可在极小空间使用
- 智能热管理，温升速度快，2秒即到350℃
- 快速补温，满足低温焊接，连续焊接温度稳定
- 实时显示加热过程温度曲线
- 自动切换模式：加热(工作)、睡眠(待机)、休眠(冷却)，延长烙铁头使用周期
- 超900种规格烙铁头，满足各种焊接工艺需求，2秒快速更换各种规格烙铁头
- USB/WLAN接口，提供联网功能，监控焊接过程和数据可追溯
- ESD认证、CE认证、QS认证

■ 产品规格

型号	品牌	工具类型	适配烙铁头	工具功率	额定功率	电源	温度范围	温度精度	校准范围	接地电阻	接地电压	真空泵	通讯方式	换咀方式
DMPSE-2HQB	JBC	通用焊笔 T245	C245	130W	640W	AC 220V 50/60Hz	90 ~ 450℃	±1.5℃	±50℃	<2 Ω	<2mV	MSE流量/流速： 570mmHg / 9SLMP MVE流量/流速： 680mmHg / 15SLMP	USB / RJ12 (RS232) / 外设模块	热插拔
		锡枪 DR560	C560	130W										
		精密焊笔 T210	C210	40W										
		小型镊夹 AM120	C120	40W										